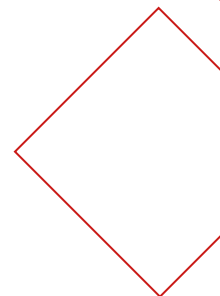


**Laserové řešení**  
pro výrobu  
polovodičů a baterií



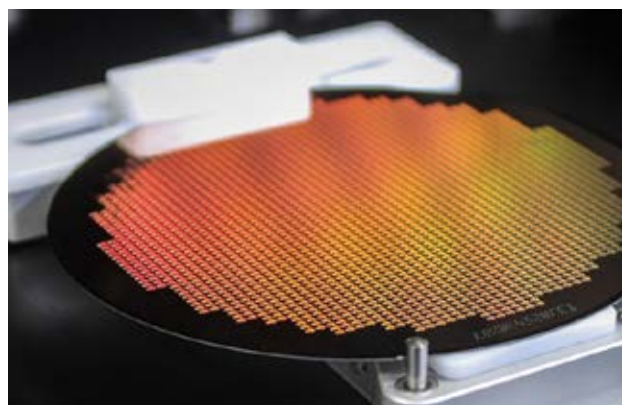
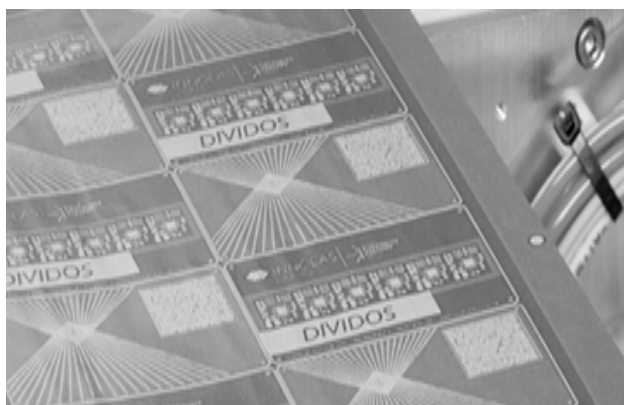
## Laserové aplikace pro výrobu polovodičů a baterií —

**LASCAM** dodává zařízení a automatizované celky se specializací na laserové obrábění a vizuální kontrolu. Působí na trhu od roku 2015 a za krátkou dobu si vybudoval postavení předního dodavatele laserových technologií v ČR.

**LASCAM** již dlouhodobě působí v oblasti implementace pokrokových plně automatizovaných zařízení pro výrobu polovodičů a baterií.

**Laserové technologie** zaznamenaly v posledních 5 letech obrovský nárůst. Na trhu se objevují nové typy s dostatečným

výkonem a délkami pulzů k desítkám „fs“. To dovoluje obrábět materiály, které doteď šly opracovat pouze složitou mechanickou cestou a v kvalitě, která byla na pomezí akceptovatelnosti.



Neustálý vývoj datových center, vozidel nové generace, čipů smartphonů a řešení 5G vyžaduje nové přístupy pro opracování pokročilých materiálů.



# Portfolio —

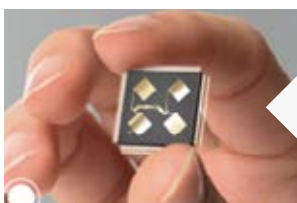
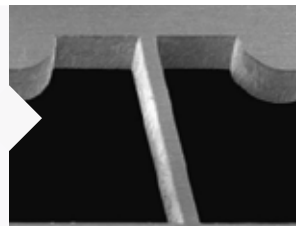


## Příprava povrchů baterií před úpravami a pájením

Implementace procesu laserového čištění před povrchovými úpravami, jako lakování nebo pájení bateriových svazků a funkčních elementů, zabezpečí maximální čistotu třídy 40 a odstraní veškeré nežádoucí vrstvy (oxidy, lubrikanty, konzervanty) až na povrch základního materiálu. Výhodou je i aktivace pomocí plazmy generované laserem těsně nad povrchem.

## Mikrostrukturalizace povrchů polovodičů

Mikroobráběcí aplikace posouvají výrobu sub-mikronových struktur kvalitativně mimo dosavadní standard a umožňují opracování silikonových wafferů, skla, keramiky nebo termo-polymerních komponentů. Implementace vhodné laserové technologie umožňuje velikosti úběru od 2  $\mu\text{m}$  s nulovým vstupem tepla do materiálu a jeho okolí.

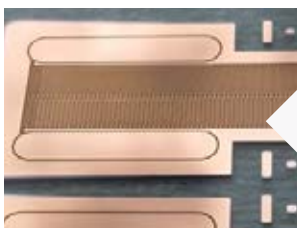


## Separace transparentních vrstev „Lid off“

Inovativní technologie využívající fyzikální povahy různé absorpce materiálů umožňují odhalování substrátu nebo Sandwichových struktur pro výrobu displejů a elektroniky.

## Řezání a depaneling PCBA a EMS desek

Implementace laserové technologie zvyšuje spolehlivost obvodů, snižuje nároky na čištění, které jsou díky této technologii eliminované a rapidně snižuje náklady. Nová skupina systémů depanelingu nabízí bezprecedentní kombinaci výkonu, spolehlivosti a hospodárnosti.



## Selektivní odstraňování vodivých vrstev

Čisté, spolehlivé, rychlé, flexibilní, vhodné do čistých prostor. Díky laserovým systémům pro selektivní odstraňování dokážeme udělat plně funkční obvody elektrosoučástek z jednoho pokoveného substrátu bez potřeby maskování.

## Svařování měděných kontaktů

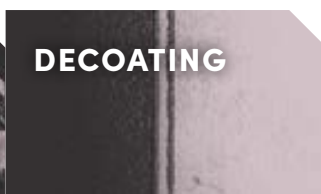
High-end modré laserové systémy pro svařování a pájení kontaktů a vodičů z materiálu jako měď, mosaz, zlato, stříbro a nevodivých kovů do výkonu až 3 kW na vlnové délce 450 nm.



## Řezání a vrtání keramických substrátů

Pulzní laserová technologie Ultrashort zaručuje optimální výsledky procesu při vrtání, značení, řezání a strukturování materiálů keramických substrátů a polovodičových destiček bez otřepů a tepelných ovlivnění nebo opálku.

## Dodáváme laserové technologie pro průmysl a vědu



## Školení a audity laserové bezpečnosti



Nabízíme školení pro splnění všech legislativních povinností pro bezpečnou práci s lasery, zejména s ohledem na zdraví zaměstnanců. Posoudíme rizika Vašeho pracoviště a doporučíme ochranné a bezpečnostní prvky v souladu s evropskými standardizovanými normami.

## Servisní služby



### TECHNICKÁ HOTLINE

Vzdálená podpora pro servisní nebo aplikační problémy. Používáme i chytré brýle.



### SERVIS NA MÍSTĚ

Dojezdové doby od 6 hod na místo i s náhradními a spotřebními díly.



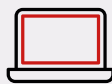
### SERVISNÍ SMLOUVY

Pružné smlouvy s možností rychlejších dojezdů, kritických dílů, preventivních prohlídek.



### CERTIFIKOVANÍ TECHNICI

Certifikace od předních světových výrobců a dlouholeté zkušenosti techniků.



### IOT – PREDIKTIVNÍ SLUŽBA

Nabízíme integraci na IOT systém, kde sledujeme Vaše zařízení v reálném čase.



### ŠKOLENÍ A WORKSHOPY

Školení laserové teorie, úprava parametrů, workshopy na Vašich zařízeních.

## Kontakty

**LASCAM SYSTEMS s.r.o.**  
Dělnická 1192/22, Holešovice  
17000 Praha  
IČ: 04224302 | DIČ: CZ04224302

**VÍCE INFORMACÍ**  
[www.lascam.cz](http://www.lascam.cz)  
[info@lascam.cz](mailto:info@lascam.cz)  
+ 420 733 735 555